# SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS

利用系活動報告

# 放射光利用研究基盤センター 散乱・イメージング推進室 顕微・動的画像計測チーム

公益財団法人高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 散乱・イメージング推進室 竹内 晃久

1. はじめに

顕微・動的画像計測チームは、その名のとおり、放 射光 X 線を利用した顕微観察と動的高速撮影の 2 つ の計測を柱としている。空間的・時間的に広いダイナ ミックレンジを網羅するマルチスケール計測、高感度 位相計測、X 線回折、分光の技術を統合したマルチモ ーダル計測に現在注力している。本チーム活動の中核 となるのは、放射光 X 線画像計測法の性能向上並びに ユーザーへの利用展開である。チームメンバーは放射 光施設または各ビームラインの特性を最大限に活か した装置開発から、ユーザー利用における企画・サポ ートまでを担う。

#### 2. 活動概要

本チームが主体的に関わるビームラインは、主に共 用 BL20B2、BL28B2、BL20XU、BL47XU である。 BL20XUとBL20B2は全長200m以上の中尺ビーム ラインである。BL28B2とBL47XUは他のグループ と共同運用している。図1に各ビームラインをどのよ うに使い分けているかを示した。横軸は空間分解能、 縦軸は使用可能なエネルギー領域を示す。視野は一般 的には空間分解能の1000倍程度である。色は利用実 験において実際にX線透過像を取得する際の典型的 な1ショットあたりの露光時間を示す。試料内部の3 次元構造を計測する CT の場合の計測時間はこれの 1000倍程度である。点線の囲みは代表的な計測手法 を示し、ここでは投影型(図中ではProjection-type)、 結像型(同Full field microscope)、回折格子を利用 した位相計測法(同 Grating interferometer,以降単 に位相計測)の3つが示されている。

投影型は 4 つ全てのビームラインで実施される最 も基本的かつ応用範囲の広い手法で、放射光を疑似平



図 1 顕微・動的画像計測チームが担当するビームラインの棲み分け状況。横軸:空間分解能、縦軸:X 線エネルギー、 色:露光時間を示す。矢印は開発の方向性。

行光と見立てた単純投影(つまり撮影原理はレントゲ ン写真と同じ)を利用している。吸収コントラスト像 のほか、放射光の高い指向性を利用して試料と検出器 の距離を調節することで試料界面の屈折が検出され る屈折コントラスト像が得られる。これは空間分解能 で100 µm 程度から1 µm 程度まで、エネルギー範囲 で7 keV から 200 keV 程度までをカバーしている。

一方、結像型はX線用のレンズで像を拡大する撮像法 である。BL20XU と BL47XU で実施されており、1 µm よりも高い空間分解能を達成するために利用され る。このために用いられるX線用光学素子は、標準的 には、電子線リソグラフィーなどの微細加工技術によ り製作されたフレネルゾーンプレート (FZP) 系のも のを利用する。位相計測は主に BL20B2 で実施されて いる。試料と検出器の間の適切な位置に2つの透過型 回折格子を配置することで、試料での位相シフト量の 積算値を定量的に求めることができる(タルボ干渉 計)。位相計測は従来の吸収によるX線像と比べて、 特に軽元素系試料に対して最大で3桁の感度利得が 期待されるため、生物・医療や有機材料によく利用さ れている。

X 線画像検出器は各装置で共通して重要な装置で ある。X線を蛍光板で一旦可視光に変換し、それをレ ンズ光学系で CMOS カメラに取り込むレンズカップ ル (場合によりファイバーカップル)を利用した可視 光変換型<sup>II</sup>を用いている。検出器は、蛍光面・ミラー・ レンズ・撮像素子により構成される。蛍光面で変換さ れた可視光のみが途中に配置されるミラーにより跳 ね上げられ、ミラーを直進するX線がレンズや撮像素 子に直接照射されることを防いでいる。蛍光面は密 度・形状・発光波長により特性が異なり、使用エネル ギーや必要とする空間分解能あるいは時間分解能に より最適なものを使い分けている。

### 3. 高度化の状況

ここからはチームが近年主に力を入れて取り組ん でいる5つのトピックについて紹介する。それぞれは 独立で取り組まれているわけではなく様々に組み合 わせることで互いの長所を伸ばしあるいは欠点を補 い、新しい利用を生み出すことに繋がっている。 3.1. 高速イメージング

BL20B2 に W/B<sub>4</sub>C 多層膜分光器が導入された。こ れは従来の Si 二結晶分光器と比べてエネルギー分解 能が落ちる代わりに、約 3000 倍程度の強度の利得が 得られる。40 keV と 110 keV 限定ではあるが、偏向 電磁石 BL ならではの照射面積の広さと、ID-BL と同 等のフラックス密度を両立したビームがユーザー実 験に供されるようになった。これにより、画素サイズ 数〜数 10 µm でフレームレート 100 kHz 級の高速イ メージングが可能になった(図 2)。ID-BL よりも広い 視野がとれることから、局所的な現象を取り逃がすリ スクを抑えることができる。

BL47XU では高負荷運転が可能な蒸発型クライオ クーラー冷却分光器の特性を活かして、試料位置で最 大 10<sup>14</sup> photons/s/mm<sup>2</sup>の高フラックスを利用した高 速高空間分解能イメージングが実施されている。視野 は 1 mm<sup>2</sup>程度に限られるものの、二結晶分光器がカ バーする 5.2~37.7 keV のエネルギー領域で画素サ イズ 1 µm でフレームレート 100 kHz の測定が可能 であり、BL47XU 第 2 実験ハッチが各持ち込み装置 対応となったことにより様々な試験機を持ち込んだ 高速実験が実施されている。

撮像素子に関しては、前述のレンズカップル式に浜 松ホトニクス ORCA-Flash 4.0やPhotron FASTCAM SA-Z に代表されるような高ダイナミックレンジ・高 フレームレートを示す CMOS を組み合わせて利用さ れている。これらは撮像素子を交換するだけで高精細 あるいは超高速撮影などに変更可能である。本グルー



図 2 過電流によりヒューズが跳ぶ瞬間の X 線像。20 kHz で撮影。過電流によりヒューズが一旦大きく 振動し (中段)、その 0.2 ミリ秒後全体が破裂する ように溶断している (下段)。 プでは、これらの検出器を評価し、実験ごとに変化す る最適な条件にあわせた検出器開発を行っている<sup>[2,3]</sup>。

3.2. 高エネルギーX線イメージング

物体への透過力が高い高エネルギーX 線イメージ ングは他測定手法だけでなく他放射光施設やラボ装 置との差別化が得られるため、積極的に開発が進めら れている。大きな試料の観察を可能にするため、これ は後述のマルチスケールイメージングとも非常に相 性がよい。一方で、物体との相互作用が小さくなるた め、感度向上を目的として屈折コントラストや位相コ ントラストを導入している。

BL28B2 では偏向電磁石からの白色光を金属フィ ルタにより低エネルギー領域をカットして 200 keV 近辺にスペクトルピークを持つ高エネルギーX 線を 取り出し、これを利用したイメージングが行われてい る<sup>(4)</sup>。LuAG (Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>: (Ce)) セラミクス蛍光体及び 高精細 CMOS カメラを組み合わせ、200 keV ビーム に対して広視野/高効率の X 線画像検出器を開発し、 画素サイズ  $3\sim12$  µm、最大視野 50 mm で金属試料 や化石試料の高精細な CT 計測が可能となった。さら に画素サイズ 1.6 µm の高分解能検出器と組み合わせ て、後述するマルチスケールイメージングも可能にな り、5 cm レベルの試料をミクロンオーダーの高分解 能で観察することが可能になった。

BL20B2 では前節で述べた 110 keV に対応した多 層膜分光器が導入されたことで高エネルギー/高分解 能/高速イメージングが可能となった。特に、中尺 BL という特性を活かして光源から 200 m 離れた第2第 3 実験ハッチで測定を行えば 10 cm 近い試料の計測 も可能である。例えばスマートフォンそのものの詳細 な内部構造なども観察できるようになった。

BL20XU では高エネルギーX 線ナノ CT が利用さ れている。エネルギー領域は現状 37.7 keV 以下と前 者2件と比べて高くはないが、ミクロン以下の3次元 構造観察が可能なナノ CT として 30 keV 以上で共用 利用されているのは世界でもここと ESRF だけである。 高エネルギーX 線専用に開発された FZP や、BL20XU の中尺 BL という特性がこの独自技術に活かされてい る<sup>55</sup>。 3.3. マルチスケール CT

「視野はできるだけ広く、分解能はできるだけ高く」 は、あらゆるユーザー、あらゆる測定において求めら れる恒久のテーマである。マルチスケール CT はこの 要求に応える目的で開発/整備された。一つの大きな 試料の全体から細部までを異なる複数の視野/空間分 解能を持つ CT 測定系で測定する方法である。光学顕 微鏡のレボルバーで視野/倍率を変えながら観察する ことと似ているが、これを3次元で行うことの技術的 困難さと、逆にこれができた時に得られる情報量の利 得は2次元の場合のそれとは格段に異なる。目的に応 じて二通りの測定手法が開発/利用されており、それ ぞれ非破壊マルチスケール法とBL 横断型マルチスケ ール法と呼ぶ。これらについて詳しく述べる。

#### 3.3.1. 非破壊マルチスケール

CT 再構成計算の定量性は投影切断面定理により証 明されているが、その前提として試料の0~180度あ らゆる角度からの投影像の幅が常に視野よりも小さ くなければならないという条件がある。ところが、こ の条件を満たさなくても、コントラストの定量値に多 少目を瞑れば、試料の内部形状を精度高く計測可能で ある。さらに、最近では CT 部分再構成法や内部 CT 再構成法などの計算法の開発によって、前述の条件を 大きく逸脱して視野よりかなり大きな試料に対して も高精度な計測が可能となってきた<sup>66</sup>。この技術を応 用して、大きな試料の全体から細部までを異なる視野 /分解能で測定していくのが非破壊マルチスケール CT 計測である。測定例を図3に示す。そもそも内部 構造の顕微観察であるにもかかわらず、試料はバルク で良い、というのはX線だからこそ許される条件であ り、その意味で他の計測手段と比べて全くユニークな



図3 石灰石のマルチスケール CT (BL28B2)。視野を 二段階に分けて CT 計測を行なっている。5 cm 近 い大きさの石灰石の塊の中に埋もれた化石のミク ロンオーダーの構造が鮮明に観察されている。

計測法といえる。利用は広い分野にまたがり、特に電 子デバイス、電池、各種材料など、オペランドやその 場観察をやりたい分野、または「はやぶさ2」のよう な無闇に物理切削ができないプライスレスな試料の 測定に相性が良い。

BL20XU と BL47XU ではマルチスケールの高分解 能モードに結像型ナノ CT が取り入れられている。大 きな試料を観察するための高エネルギー対応、広視野 CT モードとの切り替えに求められる位置・繰り返し 精度の高さなどナノ CT をマルチスケールに取り入れ るには多くの技術的困難さがあり、それを克服した本 システムは他の放射光施設と比べても先んじた技術 と言える。

### 3.3.2. BL 横断型マルチスケール

非破壊マルチスケール法は、一方で、前述のように コントラストの定量性が保証されない、視野外の構造 の影響によるノイズ除去が完全に取りきれない、測定 可能な試料の大きさに限度がある、などの欠点がある。 これらは程度の問題ではあるが、どうしても定量性や より高い精度が必要とされる場合は、関心領域を実際 に切り出した方が都合が良い場合もある。しかしここ で問題になるのは、外からは見えない試料内部の3次 元空間内の関心領域をどのように正確に切り出すの か、であり、その把握のためには、結局はまず CT 像 による全体構造の正確な調査が必要となる。我々は、 このプロセスをスムーズに実行できる環境として、BL 横断型マルチスケール CT システムを整備した。まず



図 4 大気非暴露型試料加工装置。左:大気遮断下で試料切断を行うためのグローブボックス。右上、右下:各試料専用のホルダー。不定形で脆い試料を動かないよう安定に保持しながら加工するために、予め測定した全体像の CT データから 3 次元プリンタで作成。切断部分を示す切れ込みもついているので、安全に切断ができる。

は、試料の全体像をBL20B2、BL28B2、BL20XUの 比較的視野の広い CT で計測し、関心領域の正確な位 置情報を把握する。その情報を基に関心領域を実際に 切り出し、BL20XU、BL47XUのマイクロ/ナノCTで 高分解能計測を行う、という手順である。試料の関心 領域を精度良く切り出すために、大気非暴露型試料加 工装置が導入された (図4)。 グローブボックス内に実 体顕微鏡とワイヤーソーなどの加工機器が整備され たもので試料を大気や水分から遮断された状態で加 工できる。また、試料全体の CT データを基に 3D プ リンタで各試料専用のホルダーを作ることができ、こ れによって試料加工/切断時の固定と切断位置の正確 な指定が可能になった。一連のマルチスケール計測は 一貫して大気遮断状態で行うことができ、これははや ぶさ2 試料の計測に大いに役立てられた他、電池デバ イスなどへの利用が期待されている。

## 3.4. マルチモーダルイメージング

通常の吸収コントラストイメージングが物体の透 過率分布を示す「モノクロ画像」であるのに対して、 これに位相・回折・散乱・分光などの測定技術を組み 込んで吸収率以外の位置情報を擬似カラー等で表示 するいわば「X線カラー画像」を取得することをマル チモーダルイメージングと呼んでいる。BL20XUでは、 マルチスケール CT にX線回折 CT (XRD-CT)、微分 位相X線顕微 CT を組み合わせた統合 CT と呼ばれる システムを運用している (図5)。通常の吸収コントラ ストだけでは測定できない試料内部の化学組成分布



図 5 マーチソン隕石のマルチモーダル/マルチスケー ル CT 測定例 (BL20XU)。左2つは XRD-CT に よる隕石内の各鉱物の分布を示す(左上:シリケ イト、左下:鉄含有物)。右3つは吸収コントラス トによる非破壊マルチスケール CT。 や軽元素の微妙な密度差を調べることができる。

BL47XU では結像型と走査型光学系を組み合わせ た走査/結像型 X 線 CT (Scanning/imaging x-ray microscope, SIXM) が稼働している。この装置は結 像型の full-field イメージングと走査型の定量性とマ ルチモーダル性の良いとこどりをしたような装置で あり、試料の3次元 CT 計測時に、吸収コントラスト と位相定量を同時に計測できるものである。このよう な3次元計測は、冒頭で紹介したタルボ干渉計でも行 える。SIXM はミクロン以下の顕微目的で利用され、 タルボ干渉系はそれよりも大きな試料の測定に利用 される。

#### 3.5. 自動 CT 計測装置

BL28B2 で CT の自動計測装置の運用が開始された。 コンセプトは放射光 200 keV X 線を使って、数 cm 幅の試料に関してラボ CT では得られない高精細/高 コントラスト CT 画像を「誰でも」取得できる、とい うものである。「誰でも」とは、具体的には、ユーザー は現地にわざわざ来なくても、試料を専用ホルダーに 入れて送付するだけで、測定と CT 再構成は自動で行 われ、試料とデータは後日受け取ることができるとい うことで、オンデマンドにほぼ近いシステムである。 図 6 のような装置が BL28B2 第 2 光学ハッチに設置 された。専用試料ホルダー内にユーザーによってセッ



図6 BL28B2 自動 CT 計測装置の概要。

トされた試料は、ホルダーごと試料ストッカーに設置 され、試料交換ロボットによって自動的に試料ステー ジにセットされる。CT 計測と再構成は自動で行われ、 測定が終わったものから順次試料はロボットアーム によって交換されていく。1時間あたりに測定可能な ボリュームは、測定条件にもよるが最大で直径 45 mm × 12 mm 程度、画素サイズは数~十数 µm であ る。計測事例としては汎用のリチウムイオン電池、ア スファルトなど様々であるが、例えばステンレス容器 内に封入された試料なども条件によっては測定可能 である。自動 CT 計測装置については上杉と星野によ って同号にて詳しい説明記事が掲載予定である。興味 があればそちらも参照いただきたい。

#### 4. 今後の展開

X線イメージングは生体組織や動物の in-vivo 計測、 金属材料・高分子材料や岩石・鉱物試料の in-situ 計 測、電池やデバイスのオペランド計測、歴史遺産や地 球外物質のような貴重試料の非破壊計測など適用分 野が広い。そのため図1に示したように時間・空間・ エネルギーの空間において広い範囲にわたる利用が なされ、さらなる拡張(高分解能/広視野化、高速化、 高エネルギー化)は常に要求され続けている。この図 に表されない性能としては、感度の向上、擬似カラー 化などの多次元コントラストも重要な取り組みであ り、これらは前章の高度化の中でも紹介した。さらに、 機械学習などの新たな計算技術を取り入れた測定/分 析の効率化・高速化はまだまだ開発途上の段階であり、 外部専門家のサポートも視野に入れながらさらなる 開発に取り組む必要がある。次世代光源にむけた開 発・対応についても議論と準備は急ピッチで進められ ている。例えばここで挙げた各種位相計測法、XRD-CT などは光源輝度向上によりさらなる高感度化/高 分解能化/高速化が見込まれるが、それに対応できる ような光学素子、検出器、データ処理技術の準備は必 須である。また、一般に次世代光源のメリットとして 言われる低エミッタンス/高コヒーレンスの要素だけ でなく、イメージングにおいてはビームサイズ=視野 が減少するなどのデメリットへの対策も必須である。 例えば MAX IV のイメージング BL ではこの対策と してビームエキスパンダ、ビームディフューザーが標

# SPring-8/SACLA 通信

準で装備されている。実際に SPRUC の報告書をはじ め、多くのユーザーが次世代光源に期待する測定技術 としては、依然 CT への要望が非常に高く、同時に視 野の減少に対する懸念が多く寄られている。このよう な既存ユーザーの声をしっかり受け止めつつ地に足 をつけた開発も進めていかなければならない。

本チームとしては、ユーザーの声に耳を傾けつつ、 他計測手法、ラボ光源、他の放射光施設との差別化、 つまり他では取得できないような画像情報を得るた め、SPring-8の光源性能を活かした技術開発を進めて いく。これが自ずと新しい利用や既存利用の深化に繋 がる。

## 参考文献

- [1] K. Uesugi et al.: J. Synchrotron Rad. 18 (2011) 217-223.
- [2] M. Hoshino et al.: J. Synchrotron Rad. 27 (2020) 934-940.
- [3] K. Uesugi et al.: Journal of Physics: Conf. Series 849 (2017) 012051.
- [4] M. Hoshino et al.: AIP Advances 7 (2017) 105122.
- [5] A. Takeuchi et al.: Rev. Sci. Instrum. 92 (2021) 023701.
- [6] A. Takeuchi et al.: Microsc. Microanal. 24 (2018) 106-107.

### <u> 竹内 晃久 TAKEUCHI Akihisa</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター
散乱・イメージング推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:take@spring8.or.jp